

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		Cu+galv.Cu	0.36	18+25	
2		Tr-Lam		35	
3		Prepreg	0.178		7628
4		Prepreg	0.178		7628
5		Cu	0.36	35	
6		Tr-Lam		35	
7		Prepreg	0.048		106
8		No-Flow-PP	0.063		106
9		No-Flow-PP	0.063		106
10		Abdeckfolie	0.075		PI+Kleber
11		Cu	0.065	35	PI+Kleber
12		Flex-Lam		18+25	
13		Cu+galv.Cu	0.36	18+25	
14		Tr-Lam		35	
15		Prepreg	0.178		7628
16		Prepreg	0.178		7628

Presslingsdicke* 1,49 +/- 10%

Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske* 1,60 +/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm